

# 深圳清溢光电股份有限公司

## 2026年度“提质增效重回报”行动方案

---

股票代码：688138

# Content 目录



深耕经营主业，持续巩固核心优势，为高质量发展筑牢根基



全链发力，提质增效增利



优化流程添动力，精细管理促双赢



依托人才优势，支撑技术革新，推动核心业务迭代升级



重视股东回报，落地分红政策，共享发展成果



深化投资者沟通交流，提升市场对公司核心价值的认知与认可



完善公司治理，坚持规范运作，提升企业治理效能与核心竞争力



多举措拓宽公司融资渠道，为公司持续扩张奠定坚实基础

# 前言

---

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2025年8月26日披露了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2025年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。

2026年，为进一步强化公司核心竞争力、提升经营发展质效，结合2025年度行动方案落地执行情况与公司实际经营情况，同时基于对未来发展前景的坚定信心及公司内在价值的高度认可，公司聚焦多领域部署实施提质增效举措，特制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

# 深耕经营主业，持续巩固核心优势，为高质量发展筑牢根基

2025年，公司平板显示行业掩膜版和半导体芯片行业掩膜版业务“双翼”并进，产销规模进一步扩大，营业收入稳步增长。



营业收入

123,967.01万元

同比增长11.46%



净利润

18,760.98万元

同比增长9.07%



净资产

279,189.17万元

基本每股收益0.63元

## 平板显示掩膜版业务

2025年，公司平板显示掩膜版的营业收入为9.78亿元，较上年同期增长13.83%，公司平板显示掩膜版营业收入增加的主要原因是：子公司合肥清溢光电在平板显示掩膜版业务产销持续增长，通过持续推进产能扩充与产能释放，不断强化产品质量管控体系，实现生产过程稳定、产品品质可靠；同时加大新产品研发投入与技术迭代，凭借产能优势、稳定质量及新产品布局，成功在客户端获取更多高规格产品订单。

2025年，公司AMOLED/LTPS 的营业收入达到5.16亿元人民币，较上年同期增长42.75%。目前，公司AMOLED/LTPS掩膜版已广泛应用到下游AMOLED和LTPS显示面板的产品上，包括平板电脑、手机、笔记本、手表、智能驾驶等产品。

在行业国产替代加速推进的背景下，国内核心掩膜版企业持续加大技术研发投入，不断突破关键技术瓶颈，产品矩阵日趋完善，已实现核心产品的规模化量产。目前，公司已实现8.6代OLED用掩膜版、8.6代高精度TFT用掩膜版、6代中高精度AMOLED及LTPS用掩膜版，以及中高端半透膜掩膜版（HTM）的研发与量产工作，产品性能可满足下游平板显示、半导体等领域的核心应用需求，有效填补了国内相关产

# 半导体芯片掩膜版业务

---

2025年，公司半导体芯片掩膜版业务实现稳步增长，当期营业收入达2.04亿元，较上年同期增长5.63%，营收增长主要得益于公司持续推进客户开发工作，客户拓展成果显著，下游市场需求得到有效承接。细分产品线来看，IC Foundry产品线中，功率器件相关掩膜版业务呈现快速增长态势，且半导体芯片掩膜版技术研发持续突破；IC Bumping产品线中，先进封装掩膜版业务同样实现快速增长，成为业务增长的重要支撑。

2025年，公司聚焦半导体芯片掩膜版主业高质量发展，通过持续强化技术研发实力、稳步释放产能、优化产品结构及提升细分市场份额等举措，全力推进业务提质增效。同时，公司紧抓半导体掩膜版国产替代战略机遇，在重点客户开拓方面取得突破性进展。公司重点投资建设项目按规划有序推进，现已顺利进入试生产阶段，为中高端掩膜版产能落地与规模交付提供有力保障。技术研发层面，公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版规模化量产，150nm工艺节点产品实现小批量量产；目前正稳步推进130nm - 40nm工艺节点PSM与OPC工艺掩膜版研发，并启动28nm节点掩膜版工艺开发规划，持续向高端制程突破。此外，公司已初步掌握电子束光刻、干法蚀刻等中高端掩膜版核心关键工艺，为后续产品升级与

# 圆满完成再融资，聚焦主业技术升级，夯实核心赛道竞争力

---

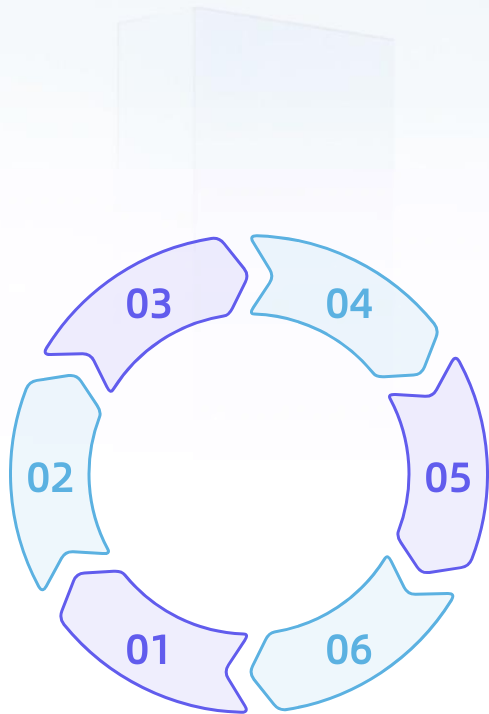
2025年4月9日，公司2023年度向特定对象发行A股股票申请获中国证监会批复同意，目前本次再融资已圆满完成，募集资金已于2025年4月23日到账。本次募投项目紧密围绕主营业务，聚焦科技创新与产能升级，旨在全面提升研发能力与核心技术水平，扩大高精度掩膜版产能，加快高端半导体掩膜版的研发攻关与产业化进程。项目建成后将有效增强对下游市场需求的响应与交付保障能力。募集资金的顺利到位，有力夯实了公司资本实力，进一步巩固了公司核心竞争优势与行业领先地位，为公司高质量发展与提质增效提供了坚实保障。

# 全链发力，提质增效增利

推动材料国产化进程，带动上游产业链发展，将有效缩短交期、降低材料成本、保障供应链安全。

产品技术方面，公司进一步完善布局，加大高端产品研发投入，提升高端产品收入占比，丰富产品组合，开辟新的利润增长点。

合肥清溢引进平板显示用掩膜版光刻机；佛山清溢于2025年顺利投产，持续扩充高端平板显示用掩膜版产能；深圳清溢积极提升半导体芯片用掩膜版的精度及后工序产能；佛山清溢微新增设备陆续到场并投入使用。



技术创新方面，根据公司的技术发展规划，加快技术开发进度，通过对接上下游产业链发展的需要，将掩膜版技术进一步在半导体芯片与平板显示应用领域进行推广，在HTM、G8.6 OLED等产品取得突破，提高技术成果向新产品转化的效率，形成新的利润增长点。

市场营销方面，公司继续实施贴近客户服务策略，和主要客户保持密切沟通，以进一步优化和完善公司产业布局。

成本领先方面，公司新建大尺寸涂胶线已量产，同时通过扩大销售及生产规模和自动化生产等措施降低生产和经营成本，提升高精度、高利润掩膜版的产品销售比重，提高公司综合产品的利润。

# 优化流程添动力，精细管理促双赢

## 2026年度提质增效核心举措

### 1 深化数智化赋能，提升运营效能

推动MES、D365等系统深度应用，打通各部门数据壁垒，实现生产过程透明化、订单状态实时可视；依托OA系统实现合规、市场等部门流程线上化，优化审批效率，推动办公智能化、集约化管理，助力产能高效释放。

### 2 优化业务与流程管控，夯实发展基础

完善运营统筹机制，建立重点事项闭环管理与督办机制，强化跨部门协同；规范订单管理，建立分级管控与快速调配机制，优化产品结构，聚焦高附加值业务；推行标准化作业流程，优化点检机制，加强零缺陷管理，保障产能与品质稳定。

### 3 强化成本管控，提升盈利水平

财务端优化融资结构，通过比价机制严控融资成本，置换高息债务；采购端推进半导体、FPD原辅材料国产替代，巩固阶段性成果；生产端推进材料分级使用、冷凝水及浓废水回收处理，降低物料与环保成本；合规端通过精细化管理降低法律服务费，全方位提升盈利能力。

### 4 聚焦技术攻坚与品质提升，筑牢科创根基

围绕清洗异常、设备故障等关键技术难题，成立跨部门攻关小组开展根因排查与改善；推进清洗工艺标准化，建立关键参数实时监控机制；开发自动化与智能比对工具，强化参数核对，预防品质事件，助力高端产品研发与量产。

### 5 完善管理机制，强化风险防控

优化设备巡检与故障预防机制，及时排查生产隐患、降低生产风险；搭建健全合规管理体系，实现各项流程规范化、可追溯；强化信息收集、分析与报送，为公司经营决策提供精准支撑。

# 依托人才优势，支撑技术革新，推动核心业务迭代升级

## （一）优化人才结构，拓宽引进人才渠道

2025年，公司持续优化人才结构，以现有人才为基础，完善员工职业发展计划，提供“管、工、技”三条职业发展通道，创造员工成长空间，同时择优引进高素质、急需的各类专业人才。



研发人员数量

131人










占公司总人数

22.24%

同比增长 28.43%

# 依托人才优势，支撑技术革新，推动核心业务迭代升级

## （二）2025年度产品技术进展

-  申请国家发明专利**14**件
-  申请实用新型专利**6**件
-  投稿论文**1**篇
-  新获授权国家发明专利**3**件
-  实用新型专利**24**件
-  软件著作权**1**件
-  发表论文**1**篇

研发投入**6,419.30**万元

同比增长**18.14%**

占营业收入比例**5.18%**

2025年新增**12**项核心工艺技术，现共拥有**98**项核心工艺技术。

# 依托人才优势，支撑技术革新，推动核心业务迭代升级

## （二）2025年度产品技术进展—研发项目进展

1、设备研发项目已完成LMM150型CD测量机研发项目。

2、工艺开发项目已完成4.5G HTM CF MASK产品开发项目，实现量产，并掌握与6代HTM相关的多重光刻技术与高精度IC掩膜版的缺陷检查技术，并完成平板及半导体相关PSM掩膜版工艺开发以及4次\*4套合曝光大尺寸异形硅片MASK制作等项目。

3、软件开发项目方面，已完成专用于MetalMask设计的图形处理技术以及应用与IC相关的图形处理技术。

4、正在开发阶段的研发项目包括LCVD250修补机研发项目、Cr系-PSM蚀刻工艺抓取项目、130nm PSM工艺研发、电子束光刻及高精度干法蚀刻技术等项目。

5、公司研发项目提升了6代高精度AMOLED/LTPS、平板显示等高精度掩膜版、FMM OLED大尺寸高精度掩膜版、中高端半透膜掩膜版（HTM）、触控PSM高精度掩膜版和半导体芯片掩膜版的技术能力。

# 重视股东回报，落地分红政策，共享发展成果



## 政策连续性

保持利润分配政策的连续性和稳定性，确保投资者预期稳定，维护公司良好的市场形象。



## 分红导向

坚持现金分红为导向，并积极响应相关政策，实施中期分红方案，优化回报机制。



## 长期价值

努力为股东创造长期可持续发展的价值，与投资者共享发展成果，切实增强投资者获得感。

## 2024年年度权益分派情况

2025年6月25日，公司每10股派发现金红利人民币**1.70**元（含税）。截至权益分派股权登记日，公司总股本314,800,000股，扣减回购专用证券账户中股份数1,723,419股后为313,076,581股，以此为基数计算合计派发现金红利人民币**53,223,018.77**元（含税），占2024年度归属于母公司所有者的净利润的**30.94%**。

## 2025年半年度权益分派情况

2025年10月16日，公司每10股派发现金红利人民币**0.9**元（含税）。截至权益分派股权登记日，公司总股本314,800,000股，扣减回购专用证券账户中股份数1,723,419股后为313,076,581股，以此为基数计算合计派发现金红利人民币**28,176,892.29**元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属母公司股东净利润的**30.61**%。

## 2025年年度权益分派情况

2026年4月24日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币**0.9**元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本314,800,000股，扣减回购专用证券账户中股份数1,723,419股后为313,076,581股，以此为基数计算合计拟派发现金红利人民币**28,176,892.29**元（含税），公司2025年度拟累计派发现金红利（包括2025年半年度分红28,176,892.29元）**56,353,784.58**元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的**30.09%**

## 实施增持，传递积极信号，共筑市场信心

为深入践行“提质增效重回报”行动理念，基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期投资价值的高度认可，公司实际控制人控制的伟华电子有限公司于2025年启动股份增持计划，拟增持金额区间为人民币2,000万元至4,000万元，截至2026年3月25日，伟华电子有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份720,834股，占公司总股本的0.23%，增持金额合计为人民币2,001.4万元，达到增持计划金额的下限，增持计划已经实施完成。此次增持既是实际控制人维护全体股东利益、促进公司稳健发展的责任体现，也通过真金白银的投入，向市场传递了与投资者利益深度绑定的积极信号。

# 深化投资者沟通交流，提升市场对公司核心价值的认知与认可

---

2025年，公司始终将保护投资者利益作为核心工作导向，严格恪守《投资者关系管理制度》要求，聚焦提质增效、精准沟通，构建起全方位、多层次、高效率的投资者沟通矩阵。通过常态化开展业绩说明会、精准对接机构调研、高效运营上证E互动平台、推动核心管理层接受权威媒体采访等多元化渠道，强化核心管理层深度参与力度，主动、及时、准确回应市场关切，全面传递公司经营理念与发展逻辑，持续增进投资者对公司经营状况、发展战略的全面认知与价值认同，切实提升投资者关系管理工作质效，筑牢投资者信任根基。

2026年，公司将构建与资本市场持续、高效的双向对接机制，计划举办不少于3次业绩说明会，积极组织线上线下调研活动，优化中小投资者沟通渠道，确保信息传递及时、准确、全面，切实维护全体股东的合法权益，提升市场对公司提质增效成果及核心价值的认可。

# 完善公司治理，坚持规范运作，提升企业治理效能与核心竞争力

2025年，公司对标新《公司法》，修订《公司章程》，取消监事会并增设1名职工董事，提升董事会的专业性与多元化水平。同时，系统梳理内部治理制度，修订27项制度，废止《监事会议事规则》，制定《董事离职管理制度》，持续完善合规管理体系，为公司规范运作提供制度保障。

此外，公司执行委员会每月定期与管理层沟通，围绕市场行情变化、业务结构优化、人力资源管理、组织发展及风险内控等关键议题深入研讨，持续提升管理层的战略引领与管控能力，推动公司整体治理效能迭代升级。

2026年，公司将持续关注法律法规修订，及时完善内部治理制度，确保合规运作，为企业稳健运营及提质增效举措落地保驾护航。

# 多举措拓宽公司融资渠道，为公司持续扩张奠定坚实基础

2024年8月至2025年4月，公司2023年度向特定对象发行A股股票申请依次获得上交所受理、审核通过及证监会同意注册批复，2025年已完成发行工作。本次募集资金围绕主营业务展开，有助于提高高精度掩膜版产能、推进高端半导体掩膜版开发及产业化，保障产品交付，增强公司竞争力，为公司全面推进提质增效、实现持续发展提供坚实的资金支撑。

2026年，公司将多举措拓宽融资渠道，持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施情况，及时履行信息披露义务，始终专注主业发展，不断提升核心竞争力与盈利能力，切实履行上市公司责任，将提质增效成果转化为股东回报，回馈全体投资者。

# 风险提示

---

清溢光电2026年度“提质增效重回报”行动方案，系结合公司当前经营实际制定的发展计划。未来实施过程中，可能受国内外市场环境变化、行业政策调整等多种因素影响，方案落地效果存在一定不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。公司将持续跟踪评估专项行动方案各项举措的推进与实施效果，严格按照相关规定履行信息披露义务，力争以优良的经营业绩、规范的公司治理及积极的股东回报，切实履行上市公司主体责任，回馈广大投资者的信任与支持。

深圳清溢光电股份有限公司

2026年4月24日